

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-008

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☒其他（<u>电话会议</u>）
参与单位名称及人员姓名	中信证券、长信基金、中信保诚基金、源峰基金、宁波三登投资、金圆资本、申万宏源
时间	2025 年 7 月
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理李大林先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、2.5D 先进封装进展？ 公司 2.5D 封装已于 2024 年四季度完成通线，目前正积极与客户进行产品验证。 2、下游应用领域营业收入占比结构？ AIoT 占比 70%；PA 占比 10%；安防占比 10%；车规和运算占比 10%。 3、台系客户业务拓展逻辑？ 中国台湾客户基于供应链安全、成本、交付及时性等多种考虑在寻求供应链本土化。从商务角度来说，在技术水平相当接近的情况下，公司在成本、交付、服务、稳定性等方面都具有一定的竞争优势。作为一家专注于中高端先进封装的封测企业，公司已经形成了以各细分领域龙头设计公司为核心的客户群，对台系客户也存在较大吸引力。 4、公司未来业务主要增长点？

	首先，公司身为国内头部端侧 SoC 客户的核心供应商，承接了较多的新品开发项目，会伴随其业务量一同成长；其次，基于 local-for-local 的供应链模式趋势，海外新客户拓展顺利，预计未来营收占比逐年增加；另外，公司与车规领域头部客户合作的车载 CIS 已经稳定量产，营收增长迅速；最后，生成式 AI、高算力芯片等新兴需求也将会给公司带来新的业务增量。 5、目前稼动率情况？ 2025 年 Q1 存在春节假期影响和季节性波动，但公司下游需求旺盛，稼动率维持高位；Q2 稼动率相对 Q1 环比进一步上升，产能趋于饱满。 6、为什么公司财务费用率相比同行业较高？ 公司成立时间较短，银行贷款等债权融资较多，未来随着公司经营活动现金流累积、股权融资增加，资产负债表将进一步优化，进而降低财务费用率。 7、二期项目未来投资规划？ 公司二期规划总投资 110 亿，重投资的基建部分已基本完成，后续投资主要是先进封装的设备以及厂房装修，公司将根据终端市场的需求变化情况，审慎稳妥控制投资节奏。 8、稳态毛利率情况？ 公司期待的稳态毛利率在 25%~30%，与公司目前的产品结构规划相匹配。 9、今年的折旧情况？ 2025 年折旧的绝对金额预计相比 2024 年仍会上涨。 10、如何看待 AI 发展带来的先进封装业务增量？ 从中长期来看，AI 发展所带来的先进封装业务增量是比较确定的。主要从两个维度驱动先进封装的需求增长：一方面，底层运算芯片会运用到 2.5D 先进封装方案，目前已经有客户产品在验证过程中；另一方面，端侧 AI 客户的产品如
--	--

	AI 手表、AI 眼镜等也会对 2.5D 先进封装方案有需求。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 7 月 30 日